

公司代码：688372

公司简称：伟测科技

上海伟测半导体科技股份有限公司
2025年年度报告摘要



第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容。

3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2025年度实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分派现金红利5.50元（含税）。以公司截至2026年4月2日的总股本167,764,661股为基数测算，合计分派92,270,563.55元（含税）。

如在公司董事会决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将维持每股分派比例不变，相应调整拟分派现金红利总额，并另行公告具体调整情况。

公司2025年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，本次分配方案还须经股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	伟测科技	688372	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王沛	刘丹
联系地址	上海市浦东新区东胜路38号D区1栋	
电话	021-58958216	
传真	无	
电子信箱	ir@v-test.com.cn	

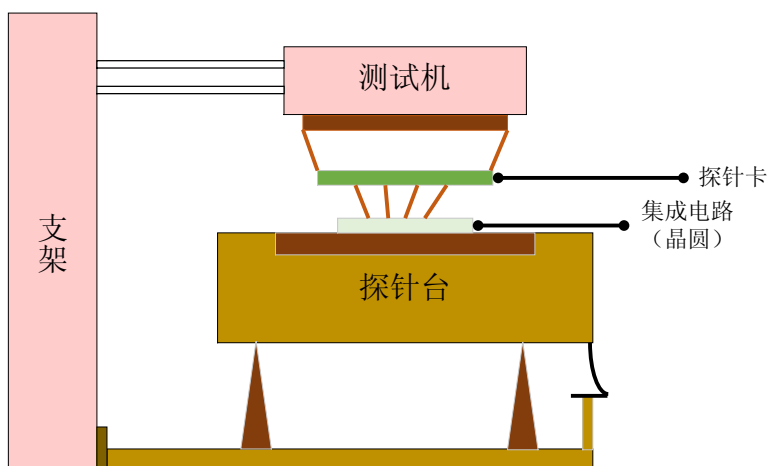
2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内知名的第三方集成电路测试服务企业，主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。公司目前拥有晶圆测试、芯片成品测试及测试方案开发、SLT测试、老化测试等全流程测试服务，测试的晶圆和成品芯片在类型涵盖 CPU、GPU、MCU、FPGA、SoC 芯片、AI 芯片、射频芯片、存储芯片、传感器芯片、功率芯片等芯片种类，在工艺上涵盖各类制程，在晶圆尺寸上涵盖 12 英寸、8 英寸、6 英寸等主流产品，在下游应用上包括通讯、计算机、汽车电子、工业控制、消费电子等领域。

1、晶圆测试

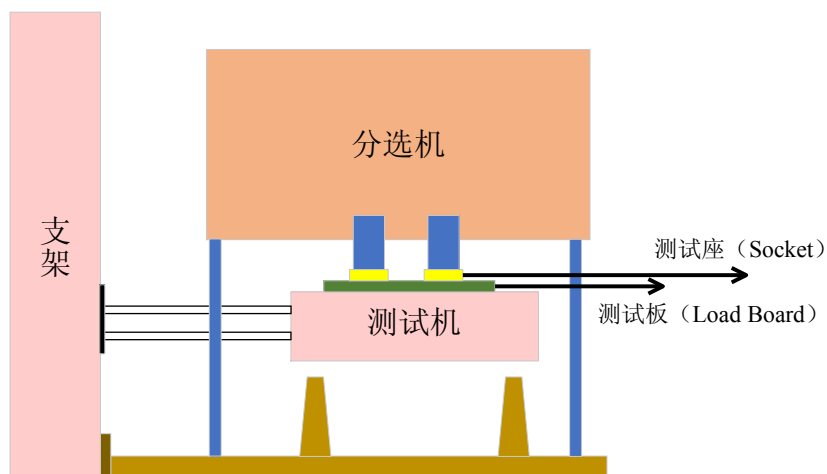
晶圆测试（Chip Probing），简称 CP，是指通过探针台和测试机的配合使用，对晶圆上的裸芯片进行功能和电参数测试，其测试过程为：探针台将晶圆逐片自动传送至测试位置，芯片的端点通过探针、专用连接线与测试机的功能模块进行连接，测试机对芯片施加输入信号并采集输出信号，判断芯片功能和性能是否达到设计规范要求。测试结果通过通信接口传送给探针台，探针台据此对芯片进行打点标记，形成晶圆的 Mapping，即晶圆的电性测试结果。晶圆测试系统通常由支架、测试机、探针台、探针卡等组成，示意图如下：



2、芯片成品测试

芯片成品测试（Final Test），简称 FT，是指通过分选机和测试仪器的配合使用，对封装完成后的芯片进行功能和电参数测试，其测试过程为：分选机将被测芯片逐个自动传送至测试工位，被测芯片的引脚通过测试工位上的基座、专用连接线与测试仪器的功能模块进行连接，测试仪对芯片施加输入信号并采集输出信号，判断芯片功能和性能是否达到设计规范要求。测试结果通过通信接口传送给分选机，分选机据此对被测芯片进行标记、分选、收料或编带。

芯片成品测试系统通常由测试仪、分选机、测试座组成，示意图如下：



3、其他服务

为了更好地服务客户、增强客户粘性，公司还会向客户提供测试设备租赁、测试辅材的销售等服务。另外，公司提供的 SLT 测试、老化测试、In Tray Mark、Lead Scan 作为增值服务与基础测试整合为覆盖芯片测试全链条、高度集成化的一站式解决方案。

2.2 主要经营模式

1、盈利模式

公司通过自主研发的集成电路测试技术、先进的集成电路测试设备以及高效快捷的测试生产和技术服务体系，向芯片设计企业、晶圆制造企业、封装企业和 IDM 企业提供晶圆测试、芯片成品测试服务，从而获取收入、赚取利润。

2、生产模式

公司根据客户订单及自身产能情况安排测试服务，并对测试产能进行总体控制和管理，及时处理测试中的生产问题，保证测试作业的顺利完成。公司的生产工作主要由制造部下属的各测试工厂来承担，其他部门配合完成。实际运行中，公司生产部门在接收客户来料后，相关部门完成客户信息建档和来料检验，销售客服部投单排产，生产部门依照工单组织测试作业。

3、销售模式

公司测试服务采用直销的销售模式，主要的客户群体为集成电路设计、制造、封装和 IDM 企业，客户分布区域以长三角地区为主，向南延伸至珠三角地区，向北延伸至东北地区，向西延伸至西部地区。在销售的组织架构方面，公司的销售工作由销售客服部承担，销售客服部设置市场销售和客服计划两大职能岗位。市场销售人员主要负责营销方案的制订、新客户的接洽及引进，客服计划人员主要负责投料排产、客户关系维护以及回款管理等。

在客户开拓方面，公司目前已建立起一支专业能力强、行业经验丰富的销售团队，主动开发各类新客户。同时，基于公司服务品质的良好口碑，老客户引荐也是公司十分重要的获客方式。在销售定价方面，公司销售人员经前期洽谈确定客户需求后，与客户商量确定测试服务价格，由于各家客户的晶圆及芯片都是不同的，因此测试服务价格以测试平台的配置和所需的工时为基础进行定价。在合同签订及结算方式方面，公司成功进入客户的供应商体系后，双方签订框架性协议，开展长期合作。公司针对不同客户采取不同的信用政策，一般客户的信用期为 30-90 天，资金结算方式以银行转账为主。

4、采购模式

公司的采购类别主要包括测试设备、测试辅材及其他类的采购。测试设备主要包括测试机、探针台、分选机等，以日本、中国台湾、美国、韩国等国家和地区的进口设备为主，亦有部分国产设备，主要根据产能需求、市场状况并结合不同设备的交期情况进行采购；测试辅材主要包括探针卡、插座、治具、包装材料等，主要根据季度或月度的备件计划并结合具体测试项目的需求状况进行采购；其他类主要包括日常办公设备、设备维护材料等，主要根据生产及办公的实际需求进行采购。

公司各部门所需原材料均通过采购部门集中采购，并按照公司《采购控制程序书》《供应商管理程序书》执行采购制度。

公司已获得 ISO9001、ISO14000、IATF16949、ISO45001 等质量管理体系认证。在新供应商准入方面，除了考察供应商质量、价格、交期、技术水平外，还要求其通过相关行业的质量认证体系，通过资格审查和认证稽核的供应商才能够进入公司《合格供应商名录》。对于现有供应商，公司根据《供应商控制程序书》定期对供应商进行审核，确保供应商的产品符合公司的生产要求。

5、研发模式

公司采取市场为导向、客户需求为核心的研发战略，形成了完整、高效的创新机制，建立了完善的研发流程管理制度。公司的研发工作由研发中心承担，主要研发方向有三个：一是不同类型芯片尤其是高端芯片的测试工艺难点的突破和具体测试方案的开发；二是各类基础性的测试技术的研发以及测试硬件的升级和改进；三是自动化生产、智能化生产等 IT 系统的研发。

公司建立了科学规范的、以项目为核心的研发管理体系，并形成了一套完善的研发流程管理制度。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 公司所属行业

公司主营业务为集成电路测试服务。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，公司所属行业分类为“C 制造业”门类下的“C3973 集成电路制造”小类。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“1. 新一代信息技术产业之 1.2 电子核心产业之 1.2.4 集成电路制造”。

(2) 行业发展阶段与基本特点

国家统计局数据显示，我国 2025 年 1-12 月集成电路产量累计值 4843 亿块，同比增加 10.9%；新能源汽车 1-12 月累计生产 1652.4 万辆，同比增加 25.1%；工业机器人 1-12 月累计生产 773074 套，同比增长 28.0%；服务机器人 1-12 月累计生产 18581081 套，同比增长 16.1%；智能手机产量 1-12 月累计生产 126950 万台，同比下降 0.9%；微型计算机设备 1-12 月累计生产 33186 万台，同比下降 2.9%。以上数据恰好侧面表明我国工业发展正经历从消费电子驱动主导向汽车电子和智能制造驱动主导的产业结构转型。

随着 5G、高性能计算（HPC）、人工智能（AI）、汽车电子等新兴应用的蓬勃发展，特别是 SoC、CPU、GPU、AI 芯片等高端芯片的量产，以及对可靠性要求极高的车规级芯片的国产化，带来了大量的高端测试需求。传统的测试方案已无法满足 5G 毫米波频段的测试需求，需要全新的、极其昂贵的射频测试平台；传统的“stuck-at fault”（固定型故障）测试已不足以覆盖 AI 芯片的复杂功能，测试的重点转向了功能验证和性能验证；车规级芯片的测试要求芯片在极宽的温度范围（-40°C 到 150°C）、强振动、高湿度等恶劣环境下长期稳定工作。下游需求和上游技术的双重变革，共同推动着独立第三方测试行业地位的提升。中国大陆独立第三方测试业正处于一个关键的转型期。在高速发展中迎来结构性变革，从早期的规模扩张阶段，正迈入高质量发展新阶段，行业正在经历一场深刻的结构性调整。

目前中国大陆相当比例的测试产能集中在封测一体厂商的测试部门，其业务规模领先于中国大陆的独立第三方测试企业。与此同时，在专业测试、高端测试需求不断提升的背景下，因封测厂将其主要业务、主要的设备配置、研发投入、人员等放在了封装业务上，与其测试业务相比，其封装业务的营业收入占比较大，故封测厂面临测试产能结构性失衡和测试方案开发能力不足的困境，而独立第三方测试企业凭借专业的技术水平和高效的服务速度，在测试行业的市场地位将不断提高。

(3) 主要技术门槛

集成电路测试行业属于技术密集型行业，测试服务所需的技术含量较高，在测试方案开发能力、测试技术水平以及生产自动化程度三个方面均具备相对较高的门槛。

在测试方案开发方面，公司持续增加研发投入，突破了先进制程芯片、5G 射频芯片、高性能 CPU 芯片、FPGA 芯片、复杂 SoC 芯片等各类高端芯片以及高算力高性能芯片、车规及工业级高可靠性芯片的测试工艺难点，成功实现了国产化替代。

在测试技术水平方面，公司在晶圆尺寸覆盖度、温度范围、最高 Pin 数、最大同测数、最小 Pad 间距、封装尺寸大小、测试频率等参数上保持国内领先，并与国际巨头持平或者接近。

在测试作业的自动化方面，公司对标国际巨头，通过将测试作业中积累的技术和经验融入 IT 信息系统，自主开发了符合行业特点的生产管理系统，提升了测试作业信息化、自动化、智能化水平，提高了测试作业的准确率和效率。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内知名的独立第三方集成电路测试企业，先后被评为国家高新技术企业、国家级“专精特新”小巨人企业、上海市企业技术中心。自成立以来，公司资产规模稳步提升，营业收入持续增长，已成为第三方集成电路测试行业成长性最为突出的企业之一。截至目前，公司已经发展成为独立第三方集成电路测试行业中规模位居前列的内资企业之一。报告期内，公司持续巩固行业领先地位，扩大竞争优势。

公司积极把握集成电路测试产业的国产化替代的趋势，一方面加大研发投入，重点突破各类高端芯片的测试工艺难点，另一方面大力扩充高端测试的产能规模。截至目前，公司高端测试设

备机台数量在中国大陆行业领先，已经成为中国大陆高端芯片测试服务的主要供应商之一。公司的技术实力、服务品质、产能规模获得了行业的高度认可，积累了广泛的客户资源。截至目前，公司客户数量 200 余家，客户涵盖芯片设计、制造、封装、IDM 等类型的企业，其中不乏紫光展锐、中兴微电子、晶晨股份、兆易创新、复旦微电、比特大陆、安路科技、地平线、甬矽电子、卓胜微、普冉股份、中芯国际、瑞芯微、纳芯微、集创北方、翱捷科技等知名厂商。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

受益于国内庞大的电子产品制造需求、5G、人工智能、物联网、新能源汽车等新兴产业的强劲拉动，以及国内芯片设计公司（Fabless）的快速崛起，中国大陆对芯片测试的需求呈现爆发式增长。2025 年，AI 芯片、CPU、GPU、车规芯片等高价值芯片测试需求成为行业增长的核心驱动力。据美国半导体行业协会（SIA）表示，2025 年全球半导体销售额为 7,917 亿美元，同比增长 25.6%，2026 年预计将达 1 万亿美元；2025 年中国半导体销售额首次突破 2000 亿美元，超过 2100 亿美元，同比增速超过 15%，占全球总额约三成。中国大陆集成电路测试市场正处于“需求旺盛+政策强力驱动+国产替代加速”的历史性交汇点，市场空间广阔，增长动能强劲。

随着 Chiplet、三维集成等先进封装技术的普及，测试技术面临全新挑战。先进封装会导致测试次数倍增，高算力、高可靠性和高性能芯片的测试成本占比会有所上升，它正在推动测试从芯片制造的“辅助环节”走向“核心价值环节”，并重塑整个产业链的分工格局。第三方测试企业不再是被动执行的后端测试程序，而是能通过早期介入设计环节，提出可测试性设计的建议；通过专业的测试方案优化，降低测试成本；通过系统级测试和可靠性测试积累的数据，反哺设计和制造环节的良率提升。

集成电路测试服务最初主要由封测一体企业的测试部门对外提供，随着行业分工的细化，出现了独立第三方测试的模式并发展壮大。芯片设计公司和制造企业越来越倾向将测试分析环节交由专业第三方，以专业化分工实现资源优化配置。随着第三方测试企业对高端设备需求的增加，国产测试设备凭借多年的技术积累与研发投入以及在成本控制、交货周期和本土化售后服务方面的天然优势，导入进程也在加快。

集成电路测试行业具有“大者恒大”的客观规律。测试行业属于资本密集型领域，头部企业凭借庞大的设备保有量与规模化采购优势，不仅能获得更优的设备采购条款，还能通过集中调配产能，在满足客户大批量交付需求的同时，维持行业领先的毛利率水平。这种成本优势使中小厂商难以追赶；主流芯片设计厂商对测试服务的精度、稳定性及交付时效有严苛要求，通常会选择产能充足、技术积累深厚的头部测试企业合作，充足的产能规模能够吸引高端客户订单，而高端客户的积累又反哺测试企业技术研发，形成正向循环。未来行业并购整合将加速，市场份额向头部企业集中。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	7,726,481,316.61	4,919,016,975.28	57.07	3,608,104,998.73
归属于上市公司股东的净资产	2,967,369,720.90	2,619,076,189.03	13.30	2,458,667,718.78
营业收入	1,574,642,416.39	1,076,869,868.17	46.22	736,524,835.36

利润总额	318,547,098.37	136,188,296.00	133.90	95,727,969.95
归属于上市公司股东的净利润	303,198,635.91	128,228,784.44	136.45	117,996,286.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	226,597,084.66	107,811,223.74	110.18	90,678,572.15
经营活动产生的现金流量净额	706,080,184.32	621,805,601.66	13.55	462,549,416.97
加权平均净资产收益率(%)	10.85	5.06	增加5.79个百分点	4.89
基本每股收益(元/股)	2.04	0.87	134.48	0.80
稀释每股收益(元/股)	1.96	0.87	125.29	0.80
研发投入占营业收入的比例(%)	10.92	13.22	减少2.30个百分点	14.09

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	285,217,551.52	349,035,077.30	448,316,656.46	492,073,131.11
归属于上市公司股东的净利润	25,918,206.33	75,160,182.52	101,353,460.27	100,766,786.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,175,535.45	39,541,748.80	90,179,721.89	82,700,078.52
经营活动产生的现金流量净额	197,884,891.25	141,557,922.03	160,488,844.51	206,148,526.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	12,821
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,384
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）							
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海蕊测半导体科技有限公司	10,542,807	45,685,496	30.65		无	0	境内非 国有法 人
香港中央结算有限公司	8,537,322	9,479,962	6.36		无	0	其他
江苏昶泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）	-3,265,009	3,631,122	2.44		无	0	其他
永赢长远价值混合型证券投资基金	2,016,291	2,016,291	1.35		无	0	其他
永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金	1,787,298	1,787,298	1.20		无	0	其他
宁波芯伟投资合伙企业（有限合伙）	-470,088	1,706,934	1.15		无	0	其他
易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	1,660,682	1,660,682	1.11		无	0	其他
德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金	-120,169	1,400,000	0.94		无	0	其他
南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	402,738	1,350,336	0.91		无	0	其他
张林恩	817,001	1,070,740	0.72		无	0	境内自 然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东蕊测半导体与其他股东无关联关系或一致行动关系； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5、公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司实现营业收入 157,464.24 万元，同比增加 46.22%；公司归属上市公司股东的净利润为 30,319.86 万元，同比增加 136.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 22,659.71 万元，同比增加 110.18%。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用